



MCP11A1CFNE3

Număr parc	MCP11A1CFNE3	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Freescale / NXP Semiconductors	Starea stocului	5351 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT ROMLESS 52PLCC	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de MCP11A1CFNE3

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	4.5V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	52-PLCC (19.1x19.1)
Viteză	3MHz	Serie	HC11
Dimensiunea RAM	256 x 8	Tip memorie program	ROMless
Dimensiunea memoriei programului	-	Periferice	POR, WDT
Pachet / Caz	52-LCC (J-Lead)	Pachet	Tube
Tip oscilator	External	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	38	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	512 x 8	Convertoare de date	A/D 8x8b
Core dimensiune	8-Bit	Procesor Core	HC11
Conectivitate	SCI, SPI	Numărul produsului de bază	MCP11

Vești înrudite



Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/03/16

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile de date, vehicule și PV

2023/09/7

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu Future Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/08/21

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile de date, vehicule și PV

2023/08/31